

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 7 月 4 日 (04.07.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/140822 A1

(51) 国际专利分类号:
C09G 1/02 (2006.01) **H01L 21/304** (2006.01)
C09G 1/00 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2023/142419

(22) 国际申请日: 2023 年 12 月 27 日 (27.12.2023)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202211697964.7 2022 年 12 月 28 日 (28.12.2022) CN

(71) 申请人: 安集微电子科技(上海)股份有限公司(ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD) [CN/CN]; 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。

(72) 发明人: 刘天奇(LIU, Tianqi); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。周文婷(ZHOU, Wenting); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。荆建芬(JING, Jianfen); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。王苗苗(WANG, Miaomiao); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。姚颖(YAO, Ying); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。宋凯(SONG, Kai); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。蔡鑫元(CAI, Xinyuan); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。李昀(LI, Yun); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。王拓(WANG, Tuo); 中

国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。王正(WANG, Zheng); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。唐浩杰(TANG, Haojie); 中国上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区(南区) T6-9 幢底层, Shanghai 201201 (CN)。

(74) 代理人: 北京大成律师事务所(BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP); 中国北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层, Beijing 100020 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则 4.17 的声明:

- 关于申请人有权申请并被授予专利(细则 4.17(ii))
- 关于申请人有权要求在先申请的优先权(细则 4.17(iii))
- 发明人资格(细则 4.17(iv))

(54) Title: CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING SLURRY

(54) 发明名称: 一种化学机械抛光液

(57) Abstract: The present invention provides a chemical-mechanical polishing slurry for polishing an amorphous carbon material. The chemical-mechanical polishing slurry in the present invention comprises abrasive particles, a compound containing a carboxyl group, and a compound containing two or more hydroxyl groups. The chemical-mechanical polishing slurry in the present invention has a relatively high amorphous carbon material removal rate, and has a good market prospect.

(57) 摘要: 本发明提供了一种无定形碳材料抛光的化学机械抛光液。本发明中的化学机械抛光液, 包括研磨颗粒, 含有羧基基团的化合物及含有两个或多个羟基的化合物。本发明中的化学机械抛光液具有较高的无定形碳材料的去除速率, 具有良好的市场前景。

[见续页]



WO 2024/140822 A1

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。